

Flight252P 系列

材料研发首选

- Flight 252P系列适用于行业客户小批量制造，同时为科研机构研发3D打印高温新材料提供无限可能。

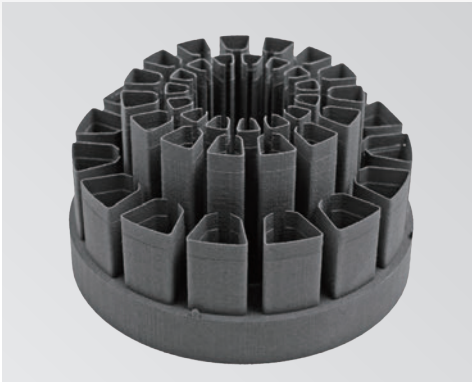
灵活生产、高效率

- 超高温版Flight ST252P可批量烧结熔点290°C及以下材料，高温版Flight HT252P可用于熔点230°C及以下材料3D打印。Flight ST252P具有紧凑的成形缸尺寸，为生产提供高效灵活性。同时，Flight ST252P的激光能量分布更佳均匀，扫描速度可达20米/秒。

实现薄壁极限*

- 光纤激光器拥有更长的使用寿命，性能更稳定。独特的扫描算法使其生产的部件具有更佳细节，壁厚最小可达0.3毫米。

* 该功能须由华曙提供定制工艺参数。



样品名称：线架
打印设备：Flight HT252P
打印材料：FS3201PA-F

该工件壁厚仅0.4mm左右，对于普通SLS技术来说，很难满足需求，同时工件韧性也难以保证。Flight技术可实现0.3mm左右的薄壁，同时具有一定的韧性，满足该工件的各项需求。

技术参数	Flight HT252P	Flight ST252P
外形尺寸 (L×W×H)	1735mm×1205mm×1975mm	1735mm×1225mm×1975mm
成形缸尺寸 ¹ (L×W×H)	250mm×250mm×320mm	
设备净重	约1700kg	
铺粉层厚	0.06~0.3mm可调	
扫描速度	最高达 20m/s	
激光器	光纤激光器，300W	
振镜扫描系统	动态聚焦	
最高建造腔体温度	220°C	280°C
热场控制	智能分区独立控制	
温度控制	连续实时表面温度监测	
操作系统	64 位 Windows10	
数据处理及系统控制软件	BuildStar, MakeStar®	
软件功能	开源参数调节，可实时修改建造参数，三维可视化，诊断功能	
数据格式	STL	
电源要求	380V±10%，3~N/PE，50Hz/60Hz，32A	
运行环境温度	22-28°C	
成形材料	FS4200PA-F, FS3201PA-F, FS3401GB-F, FS6140GF-F, WANFAB-PU95AB, Ultrasint® TPU 88A black 等	

¹ 实际成形体积与材料，工件等要素相关。